

ブロック HC セム 操作ステップ

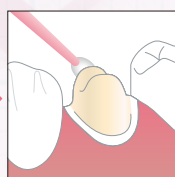
補綴装置が CAD/CAM ハイブリッドレジンブロックの場合

支台歯の処理

天然歯の場合

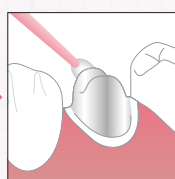
レジンコアの場合

メタルコアの場合



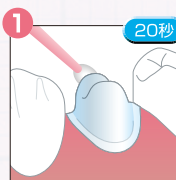
松風ポーセレンプライマーを塗布 ⇒ 10秒間自然乾燥

別売品



メタルリンクを塗布 ⇒ 10秒間自然乾燥

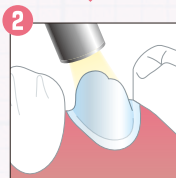
別売品



20秒

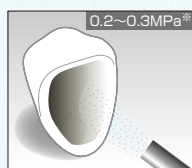


ブロックHCセム プライマーA/B等量混合 ⇒ 塗布 ⇒ 20秒間放置



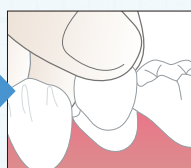
弱圧エアで乾燥

補綴装置の前処理

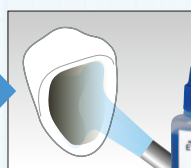


アルミナサンドブラスト処理 ⇒ 水洗又は超音波洗浄 ⇒ 乾燥

※ご使用されるブロックの添付文書をご参照ください。



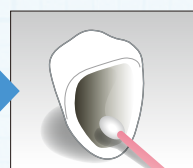
試適



補綴装置内面に付着した唾液などを水洗除去* ⇒ 乾燥

※リン酸系エッチング材またはエッチングゲルを推奨

この際、リン酸系ゲルなどを用いて唾液を洗浄することを推奨します。リン酸系ゲルなどを使用する場合、十分に水洗して、リン酸成分が補綴装置内面に残らないように注意ください。



ブロックHCセム HCプライマーを塗布 ⇒ エア乾燥



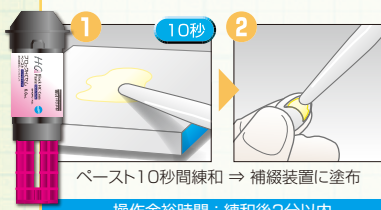
セメント操作

練和・塗布

圧接・除去

硬化

ハンドミキシング



ペースト10秒間練和 ⇒ 補綴装置に塗布

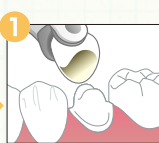
操作余裕時間：練和後2分以内

オートミキシング

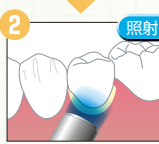


ミキサーチップを装着し直接、補綴装置に塗布

操作余裕時間：ミキサーチップより押出後2分以内

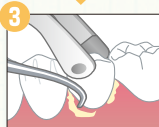


窩洞や支台歯に装着し圧接



照射1～2秒

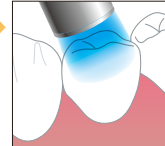
余剰セメントに1～2秒間光照射し、半硬化させた後採針などを用いて除去



※光が届かない箇所は、補綴装置装着後3～4分程度放置して余剰セメントを半硬化させる



ハロゲン20秒、LED10秒



マージン部や咬合面など各所に対してLED10秒間、ハロゲン20秒間光照射

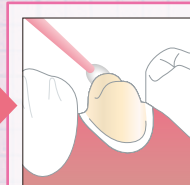
補綴装置が金属・アルミナ・ジルコニア・硬質レジン・陶材の場合

支台歯の処理

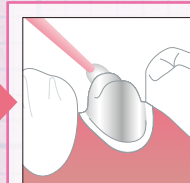
天然歯の場合

レジンコアの場合

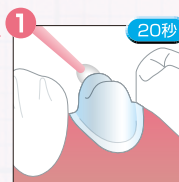
メタルコアの場合



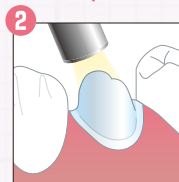
松風ポーセレンプライマーを塗布 ⇒ 10秒間自然乾燥



メタルリンクを塗布 ⇒ 10秒間自然乾燥



ブロックHCセム プライマーA/B等量混合 ⇒ 塗布 ⇒ 20秒間放置

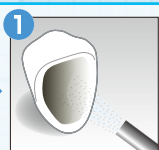


弱圧エアで乾燥

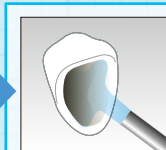
補綴装置の前処理

接着面

金属、アルミナ、
ジルコニアの
場合



アルミナサンドブラスト処理 ⇒ 水洗(または超音波洗浄)・乾燥

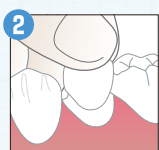


補綴装置内面に付着した唾液などを水洗除去 ⇒ 乾燥

参考: サンドブラストのゲージ圧
アルミナ・ジルコニア: 0.2~0.3MPa
陶材・硬質レジン: 0.1~0.2MPa
金属: 0.3~0.5MPa

接着面

硬質レジン、陶材の場合



試適



補綴装置内面に付着した唾液などを水洗除去※ ⇒ 乾燥
※リン酸系エッチング材またはエッチングゲルを推奨
この際、リン酸系ゲルなどを用いて唾液を洗浄することを推奨します。リン酸系ゲルなどを使用する場合、十分に水洗して、リン酸成分が補綴装置内面に残らないようにご注意ください。



松風ポーセレンプライマーを塗布 ⇒ 自然乾燥



セメント操作

練和・塗布

圧接・除去

硬化

ハンドミキシング



ペースト10秒間練和 ⇒ 補綴装置に塗布

操作余裕時間: 練和後2分以内

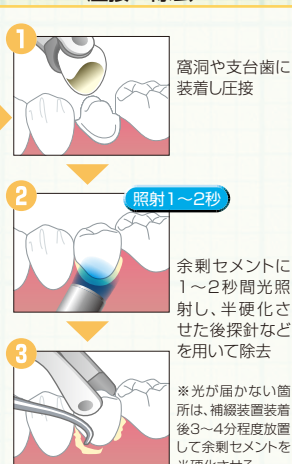
塗布



ミキサーチップを装着し直接、補綴装置に塗布

操作余裕時間: ミキサーチップより押出後2分以内

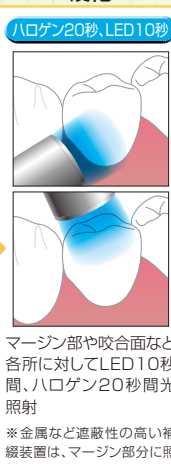
オートミキシング



窩洞や支台歯に装着し圧接

照射1~2秒

余剰セメントに1~2秒間光照射し、半硬化させた後採針などを用いて除去
※光が届かない箇所は、補綴装置装着後3~4分程度放置して余剰セメントを半硬化させる



ハロゲン20秒、LED10秒

マージン部や咬合面など各所に対してLED10秒間、ハロゲン20秒間光照射
※金属など遮光性の高い補綴装置は、マージン部分に照射してください。